課題番号 :F-15-NM-0052

利用形態 :技術代行

利用課題名(日本語):ガラスの RIE における加工直進性の金属ドープ量依存性評価

Program Title (English) : Metal-doping dependence of vertical etching of Glass by RIE

 利用者名(日本語)
 : 太田 誠吾

 Username (English)
 : Seigo Ohta

 所属名(日本語)
 : 旭硝子株式会社

Affiliation (English) : ASHAHI GLASS CO., LTD.

# 1. 概要 <u>(Summary)</u>

反応性イオンエッチング(Reactive Ion Etching; RIE)によるガラスの微細加工において、ガラス組成に応じて加工直進性が異なることが考えられる。特に微細なトレンチやホールを RIE で作製する場合、ガラス組成の影響が加工直進性に顕著に現れる懸念がある。そこで、金属ドープ量が異なるガラスを用いて RIE を行い、RIE 後の形状観察から、加工直進性を評価。その結果、今回用いたガラスのドープ量の範囲において、加工直進性はドープ量に依存しないことが分かった。

ンチ幅の RIE おいて、ガラス3種のテーパー角はほぼ 同一であった。よって、今回の評価に用いたガラスの 金属ドープ量の範囲において、加工直進性はドープ量 に依存しないことが分かった。

Table.1 Taper Angle

	トレンチ幅			
	200nm	100nm	80nm	60nm
ガラス A	84°	88°	88°	88°
ガラス B	85°	88°	89°	90°
ガラス C	82°	87°	88°	89°

## 2. 実験 (Experimental)

## 【利用した主な装置】

- · 12 連電子銃型蒸着装置
- ・ 125kV 電子ビーム描画装置
- ・酸化膜ドライエッチング装置
- 走査型電子顕微鏡

## 【実験方法】

金属ドープ量が異なるガラス基板 3 種類(ガラス A, ガラス B, ガラス C)準備した。ガラス基板上に Cr マスク(トレンチ幅 200 nm, 100 nm, 80 nm, 60 nm)を作製し、RIE を行った。RIE のプロセスガスは CHF3 (30 sccm)を使用し、プロセス時真空度 3.0 Pa、高周波パワー100 Wの条件で 5min エッチングした。続いて、Cr 膜を除去し、ガラス基板を割断した。断面形状を走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope;SEM)で観察し、テーパー角を測定した。

## 4. その他・特記事項 (Others)

なし

# 5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

なし

## 6. 関連特許 (Patent)

なし

# 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

トレンチ幅 200 nm, 100 nm, 80 nm, 60 nm の RIE 後のテーパー角測定結果を Table. 1 に示す。同一トレ